

用户名: 密码: 验证码: [1702](#)[参会登录](#)[参会注册](#)[简体](#) | [ENG](#)

2010年1月21日 星期四

[首页](#)[会议简介](#)[最新动态](#)[组委会](#)[招商/招标](#)[会议议程](#)[论文征集](#)[在线投稿](#)[在线报名](#)[住宿交通](#)[会务组联系](#)

最新动态

“2010年国际水基胶粘剂技术研讨会”预通知

为促进水基胶粘剂产业的健康快速发展,上海市粘接技术协会现决定于2010年6月2-3日,即2010年上海世博会举办之际,在上海召开“2010年国际水基胶粘剂技术研讨会”,会期两天。会议议题包括:水基胶粘剂的原料及助剂;水性胶粘剂的新产品开发、施胶工艺及设备;水性胶粘剂在建筑、运输、航空、航天、风能、机械、电子等领域中的应用。

为了使本次会议更具代表性,现诚邀国内外著名胶粘剂生产厂商、原料供应商、设备生产商、助剂生产商、胶粘剂应用单位及从事胶粘剂研发的院校机构共同参与承办或者协办本次大会,为开好本次会议贡献力量并建言献策。

现向水基胶粘剂行业相关技术人员征集会议论文及大会报告,希望各位专家、同行踊跃参加并积极投稿。凡未在国内外公开刊物发表过的论文均可投稿,论文题目及摘要请在2010年3月15日前网上提交或报大会筹备办公室。

上海市粘接技术协会近年来一直积极以召开行业会议为契机促进行业发展和同行间的交流,曾先后在2007年和2008年分别与美国诺信、国民淀粉化学、汉高股份有限公司等单位成功举办了“2007年上海国际热熔、压敏胶新产品和新技术交流会”和“2008年上海国际环氧和聚氨酯粘接技术论坛”。来自十几个国家和地区的知名企业和研究机构的500余位代表参加了会议,报告了四十多篇高水平的论文,促进了企业间的交流以及科研院校与企业的交流合作。相信在您的参与和支持下,2010年国际水基胶粘剂技术研讨会必将取得成功。

如有任何疑问,请与大会筹备办公室联系:

地 址: 上海市南昌路47号3317室 上海市粘接技术协会 (200020)

联系人: 邵洁华

电 话: 086-21-53828799

传 真: 086-21-63846382

E-mail: office@sh-adhesion.com

会议网站: www.adhesive-tech.com

欢迎积极参与大会和踊跃投稿!

上海市粘接技术协会

2009年12月14日



本站访问量: 328人

承办单位: 上海市粘接技术协会 [办会单位管理]

地址: 上海市南昌路47号3315室 邮编: 200020

TEL:086-21-53828799 FAX:086-21-63846382 EMAIL:office@sh-adhesion.com

沪ICP备09094472号 服务支持: 维程信息 技术支持: 会议网站建设专家